

5G・Beyond5Gに要求される 部品・材料の技術動向と展望

【LIVE配信】

～5G・6G用の部品・プリント基板に求められる特性とは？無線の基礎・高周波・ミリ波特性・AiPなど詳解！！～

- ◆日時：2021年10月15日（金）10:00～16:00
- ◆会場：自宅や職場など世界中どこでも受講可
- ◆聴講料：1名につき55,000円（税込、資料付）

※会員登録（無料）をしていただいた方には下記の割引・特典を適用します。

- ・1名でお申込みされた場合、1名につき44,000円（税込）
- ・2名同時でお申し込みされた場合、2人目は無料（2名で55,000円（税込））

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：特定非営利活動法人 サーキットネットワーク 副理事長 梶田 栄 氏

約120前に発明された無線通信技術の進歩は目覚ましいものがあります。また移動体通信はおよそ10年毎にステップアップしてきており、現在進行中の5G規格を理解するためには基本知識が必要です。

LTEと何が異なるのか、それを実現するには何が必要なのか、また10年先を見つめてどのような技術が必要になるのかを、無線の基礎を分かりやすく説明し詳しく解説します。

1. 携帯電話の推移および構造

2. 5Gとは

3. 5Gの用途

4. 5Gの課題

5. Beyond5G・6G

6. 電気の基礎直流と交流

7. 高周波と電磁波無線の知識

8. 高周波の特性

9. ミリ波の特性

10. Beyond5G(6G)への技術課題

11. 電子部品および材料への要求特性

12. AiP(AntennainPackage)とは

【LIVE配信セミナーとは？】

- ・本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。「ミーティング用Zoomクライアント」をダウンロードするか、Webブラウザから参加するかの2種類がございます。ZOOM WEBセミナーのはじめかた (<http://www.rdsc.co.jp/files/instruction/zoom.pdf>) をご覧ください。
- ・お申込み後、受理のご連絡メールをさせていただきます。一部メールが通常セミナー形式（受講券、請求書、会場の地図）になっておりますが、LIVE配信のみのセミナーです。
- ・お申込み後、接続テスト用のURL (<https://zoom.us/test>) から「ミーティングテストに参加」を押していただき動作確認をお願いします。
- ・後日、別途視聴用のURLをメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時の10分前に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
- ・セミナー資料は郵送にて前日までには、お送りいたします。タブレットやスマートフォンでも視聴できます。
- ・ご質問については、オープンにできるご質問をチャットにご記入ください。個別相談（他社に知られたくない）のご質問は後日メールにて講師と直接お願いします。

『5G部材【WEBセミナー】』セミナー申込書

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録（無料） ※案内方法を選択してください。複数選択可。

 Eメール
 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>